

### 三、Wenesco 静态焊锡炉

焊接电路板的另一种方法。**所有 WENESCO 焊锡炉均采用陶瓷涂层处理，可与标准或无铅合金配合使用。**使用浅焊锅焊接电路板的技术可以追溯到 20 世纪 50 年代，至今仍是一种可靠的 PCB 小批量焊接方法。

- 1、首先在电路板底部喷涂或刷上助焊剂。然后刮擦焊锡槽表面以清除表面浮渣（氧化物）。
- 2、最后，使用“电路板夹”，将电路板平浸入熔融的焊料中。
- 3、电路板将在不到五秒的时间内焊接完成。

我们的标准型号采用恒温器控制，最高温度可达 575F。

Model	Inside Size (in inches)	Solder Capacity
MPM 16	5.75 X 5.25 X 2	16 lb
MPM 25	5.3 X 9.3 X 2.5	25 lb
MPM 32	11.75 X 5.37 X 2.5	32 lb
MPM 59H	14 X 14 X 1.75	59 lb
MPM 225	18 X 20 X 3	225 lb

- 所有型号均采用恒温控制。刻度盘编号为 1-10。
- 温度范围为 450F-950F（取决于型号和恒温器）/精度约为 +/- 25F。
- 可通过电源控制将温度范围降低至 0-575F。
- 数字恒温器（P19D 的标准配置）可用于精密温度控制、温度显示和扩大范围（0-950F）。

				
（上图）型号 MPM 59H	（上图）型号 MPM16	（下图）带远程数字恒温器的 MPM 225 型	（下图）MPM 25、MPM 32（带盖） （带可选数字恒温器）	配件/选项：T99 可调节板夹可与所有扁平锅一起使用。（如下图所示）